

Express5800/T110k-Mスペック詳細

フレームモデル

2023年09月26日版

製品名称			Express5800/T110k-M				
モデル名			8x.2.5型ドライブモデル N8100-3000Y		4x3.5型ドライブ N8100-3001Y		
製品型名							
CPU	Processor		インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3408U (8C/8T, 1.80GHz, 22.5MB TDP125W), Silver 4410Y (12C/24T, 2.00GHz, 30MB TDP150W), Silver 4410T (10C/20T, 2.70GHz, 26.25MB TDP150W), Silver 4416+ (20C/40T, 2.00GHz, 37.5MB TDP165W), Gold 5415+ (8C/16T, 2.90GHz, 22.5MB TDP150W), Gold 5412U (24C/48T, 2.10GHz, 45MB TDP185W), Gold 6426Y (16C/32T, 2.50GHz, 37.5MB TDP185W),				
		標準搭載数 / 最大搭載数	0/1				
		コントローラ・ハブとの接続	DMI4 (16GB/s)				
		インテル® 64	対応				
		インテル® パーチャライゼーション・テクノロジー	対応				
		インテル® ハイバースレディング・テクノロジー	対応				
		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー	対応				
		CPUソケット形状	LGA4677				
		ホットプラグ	-				
冷却方式	ファンなしヒートシンク						
チップセット			インテル® C741 チップセット				
メモリ		搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 1TB (16x 64GB)				
		メモリソケット数	16				
		増設単位	1 ^{*7}				
		搭載メモリ	DDR5-4800 Registered DIMM (16/32/64GB)				
		最大動作周波数	4800MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)				
		メモリバス帯域(チャネルあたり)	38.4GB/s				
		メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて16wayインターリーブをサポート)				
		誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, ADDDC				
		メモリスベアリング	非対応				
		メモリミラーリング	対応				
		ホットプラグ	-				
		モジュールピン数	288 ピン				
		動作電圧	1.1V				
		バッファ機能	対応				
補助記憶装置	ドライブ ベイ	内蔵スロット	フロント	8x2.5型ドライブ 8x2.5型増設ドライブ(オプション 最大1個)		4x3.5型ドライブ 4x3.5型増設ドライブ(オプション 最大1個)	
			リア	-		-	
			ミドル	-		-	
			内部	-		-	
		内蔵標準	-		-		
			2.5型HDD: SATA 16TB (16x 1TB), SAS 38.4TB (16x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 122.88TB (16x 7.68TB), SAS 122.88TB (16x 7.68TB) (オプション増設ドライブケージ追加時)		3.5型HDD: SATA 144TB(8x 18TB), SAS 96TB(8x 12TB) (オプション増設ドライブケージ追加時)		
		内蔵最大	-		-		
			ホットスワップ		対応		
		インタフェース規格とRAID構成		N8103-243/245 SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション) N8103-244 SAS 22.5Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)			
		光ディスクドライブ		内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) ^{*1}			
		FDD		オプション: Flash FDD (1.44MB) ^{*2}			
拡張ベイ		-					
拡張スロット	対応スロット	標準構成 1x PCI Express 5.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、フルレングス) 1x PCI Express 5.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、ハーフレングス) 1x PCI Express 5.0 (x16レーン, x16ソケット) (OCPスロット) (LOMカード、OCP RAID 共用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)					
		PCI Express 1.1, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0					
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM グラフィック表示 と 解像度	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200					
		1x USB3.2 Gen1(Type A), 1x USB2.0(Type A) (BMC用) 2x USB3.2 Gen1(TypeA) , 1xアナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 1x シリアルポート (オプション) 2x 1000BASE-T LANコネクタ(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 RJ-45)					
標準インタフェース	リア	1x USB3.2 Gen1(TypeA), 1x USB2.0(TypeA), 2x SATA 3.0					
		LOM (標準構成) BCM572 対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います) 対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)					
ネットワーク	実装形式 コントローラ チェーミング ジャンボフレーム PXE / iSCSI ブート	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応					
		NEC iLO6					
		Marvell PHY					
		対応					
リモート マネージメント	コントローラ マネージメント用ポート	オプション					
		System ROM U54 v1.30 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)					
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)		1.30 (最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)					
キーボード / マウス		S0, S5					
BIOS Version (出荷当初)		対応 (オプション, ホットプラグ可)					
BMC Firmware Revision (出荷当初)		対応 (オプション, ホットプラグ不可)					
System Sleep State		タワー					
冗長電源		196mm × 574mm × 466mm (フロントベゼル/レール/突起物含まず)					
冗長ファン		20kg / 32kg		20kg / 35kg			
筐体デザイン							
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)							
質量 (最小/ 最大)							
電源		選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-159,160A,194) 500W 80 PLUS® Platinum/800W 80 PLUS® Platinum/1000W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)					
		消費電力(100V最大構成時, 最大電力)	1038VA/1037W*3		842VA/841W*3		
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)		1020VA/1017W*3		817VA/817W*3			
省エネ法(2021年度基準)に基づくエネルギー消費効率*7		15.6(区分 1)					
温度条件		動作時: 10～35℃(条件付きで5～40℃対応可) ^{*4} , 保管時: -30～60℃					
湿度条件		動作時: 8～90%, 保管時: 5～95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)					
ハードウェア認証規定		VCCI クラス A					
OS認証		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware					
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル, キーボード, マウス					
無償保証内容		3年オンサイト保守サービス(月～金, 9:00～18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年パーツ保証					
インストールOS			-				
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2019 Standard、Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2022 Standard、Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 8.6以降(2023/10/26サポート開始予定) ^{*5} , VMware ESXi™ 7.0u3以降(2023/10/26サポート開始予定), VMware ESXi™ 8.0u1以降(2023/10/26サポート開始予定)					
		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います					
動作確認OS ^{*6}							

注意事項
拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで、ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mm まで、MD2 = 167.6mm まで を示します

注釈

- *1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを全システムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1式は必ず手配してください。
- *2 必要に応じて手配してください。主な用途については「Flash FDD製品概要と利用ケース」のシステム構成ガイドを参照下さい。
- *3 CPU TDPごとの最大電力はシステム構成ガイドをご参照ください。
- *4 40℃環境においてそれぞれ構成制限及び環境制限があります。詳細はシステム構成ガイド「リファレンス」の「40℃対応についての注意事項」をご参照ください。
- *5 サポートサービスの提供を受けるにはNECよりLinuxサービスセットの購入が必要です。同一メジャーバージョン内での対応となります。
- *6 BTOインストール不可。NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux On Express5800」を参照願います。
- *7 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。